

별첨 1. 채용 상세 분야

- (1) 세부전공 : 기계, 전기/전자, Packaging 재료, 표면처리 재료, 산업공학
 (2) 응용분야 : 전자 제품 설계, 접합기술, 신뢰성, 전자파 응용, 최적 설계, Particle Trajectory, 성형(사출, 프레스 등)

전공(세부 전공)	
기계	기구설계, 구조/동역학/내충격 해석/설계, 열유체 설계/해석, 피로내구설계, 진동소음 해석/설계/측정, 정밀측정, Polymer Processing (Injection, RTM, RIM)
전기/전자	EMI/EMC, 고속신호전송, 전자파해석, Chip-Package-PCB Co-simulation, 회로/전력설계, 정전기 측정/설계
실장 재료	솔더링 재료, SMT용 고분자 재료, 반도체 패키징용 접합 재료/ 솔더링 기술, SMT 선행 공정 기술, 접합기술, 패키징기술
표면처리 재료	필름코팅, 고분자합성, 접착/표면처리 재료, 도장/도금/인쇄/증착 관련 재료기술
산업공학	생산기술 (제조 Process 개발)
응용 분야	
Set 제품 설계	휴대폰, 카메라, 컴퓨터, TV, 세탁기, 냉장고, 프린터 등 Set 제품의 기구 및 회로 설계, 실장 구조 설계
접합기술, SMT 기술	패키지, PCB Assembly 대상의 접합기술 개발 및 SMT 실장공정 개선
제품/부품 신뢰성	전자 제품의 성능 신뢰성 평가 및 예측, 부품 및 PBA 실장 신뢰성
전자파 응용기술	전자파제어를 위한 해석기반 설계, 선행기술개발 및 전자파 분석장비개발
최적 설계 기법	실험 계획, 강건 최적설계, 제조 조립성 설계
Particle Trajectory	청정환경 이물개선, 세트제품 오염방지
성형	차별화 디자인 외관을 위한 소재 및 표면처리 기술 선행개발
제품기술	Set 제품의 생산/제조 방식 개발, 신재료 성형기술
측정기술	기구부품, 광부품 평가/측정